

お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

適切に管理された森林からの原料を含むFSC®認証紙之環境に配慮した植物油インキを使用
しています。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第62期 報告書

2019年10月1日………2020年9月30日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2020年9月期における事業の概況等をご報告致します。

当期における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の広がりを受け、多方面の経済活動が抑制されたことにより、悪化基調となりました。

我が国経済につきましては、生産活動や個人消費に持ち直しの動きが見られたものの、同感染症の影響から設備投資の減速など、景気的大幅な下押しが見られました。

そのような外部環境の下、溶接機器関連事業が、自動車メーカーの慎重な設備投資動向への対応に努め、平面研磨装置関連事業が、堅調な生産活動が続いたエレクトロニクス関連素材への拡販活動を図りましたが、当社の業績は前期を下回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2020年4月から9月までに1,066,700株(自己株式を除く発行済株式総数の6.29%)の自己株式を取得するとともに、当期の配当金につきましては、2020年2月28日に公表の業績が概ね計画通りに推移したことなどから、1株当たり期末配当金を70円とし、年間配当金を110円とす



る案を2020年12月18日開催の定時株主総会に付議し、決議致しました。

次期も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績の向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2020年12月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	



連結業績サマリー

(百万円)

	実績			次期(第63期)の見通し	
	前期(第61期)	当期(第62期)	前期比	期初計画	当期比
売上高	51,727	44,230	△14.5%	42,400	△4.1%
営業利益	9,619	6,754	△29.8%	5,100	△24.5%
経常利益	10,084	7,474	△25.9%	5,500	△26.4%
親会社株主に 帰属する当期純利益	7,476	5,103	△31.7%	3,800	△25.5%
1株当たり配当金	110円(年間)	110円(年間)	—	110円(年間)	—

※次期(第63期)の見通しの想定為替レートは、1米ドル=105.00円を前提としております。

当期の連結業績について

当社グループと深く関わる自動車業界につきましては、世界経済の動向を受けて慎重な設備投資が行われ、生産活動も総じて減速状況が続きました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、先端製品の需要が堅調推移する中で、半導体デバイス向け設備投資に一部活性化の動きも見られました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めたものの、当社の業績としましては、前期を下回る結果となりました。

次期の見通しについて

当社グループと深く関わる自動車業界では、市場環境の急速な変化に対し新型車投入が継続されていますが、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大や通商問題の長期化などへの懸念から、堅調ながらも慎重な投資動向が予想されます。また、エレクトロニクス業界では、デジタル化の世界的な加速を受け中長期的な設備投資意欲が高まる一方、足元におけるエレクトロニクス関連素材の設備投資需要については、調整的な推移が予想されます。

そのような環境下、当社グループとしましては、業績の向上に鋭意注力すべく、成長市場での販売促進を図るとともに、積極的な設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=105.00円の為替レートを前提としています。

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

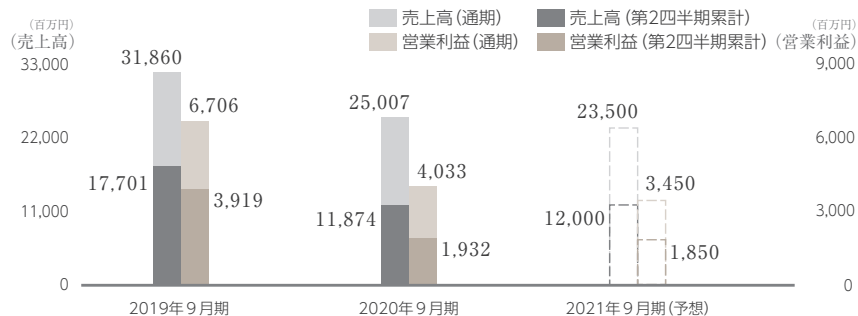
抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



溶接ガン



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

売上高構成比

25,007 百万円……2020年9月期 売上高

平面研削装置関連事業

溶接機器
関連事業

56.5%

溶接機器関連事業につきましては、中国市場において、春節後、設備需要の早期堅調化が見られたものの、世界各地で、取引先の設備投資が総じて弱含む流れを示しました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったものの、業績は前期を下回りました。

この結果、当事業の売上高は250億7百万円(前期比21.5%減)、同営業利益は40億33百万円(前期比39.9%減)となりました。

セグメント別事業概況

平面研磨装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

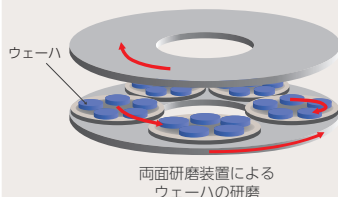
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

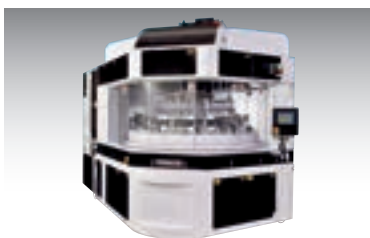


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

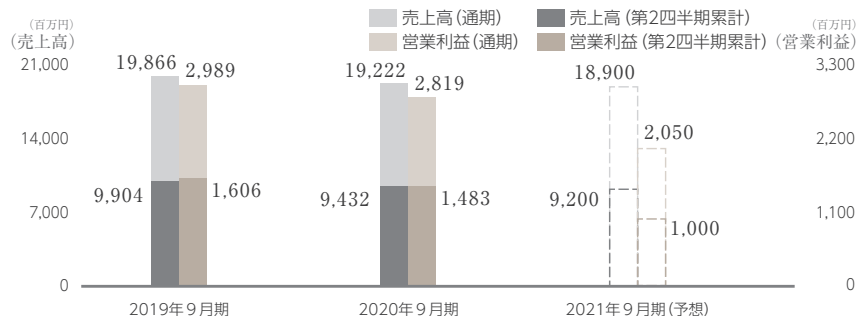
精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



両面研磨装置



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

売上高構成比

19,222 百万円……2020年9月期 売上高

溶接機器
関連事業

平面研磨装置関連事業

43.5%

トピックス

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Chinaに出展

当社グループは、2020年6月、上海(中国)で開催された半導体製造技術の展示会「SEMICON China」において精密研磨装置などを紹介し、シリコンウェーハや化合物半導体・ガラス基板等のアプリケーションに対する最新の取組みを紹介しました。また、ご来場の方々に対し、豊富な装置ラインナップと各種消耗副資材による効果的な製造プロセスについてのプレゼンテーションを行いました。

当社グループは、今後とも成長が予想される市場に向けて、積極的な製品展開を図ってまいります。



片面研磨装置



SEMICON China 2020

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Taiwanに出展

スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成される基板材料の高精度化が進んでいます。2020年9月、台北(台湾)で開催された半導体製造技術の展示会「SEMICON Taiwan」にて、次世代シリコンウェーハに適応した装置・消耗副資材の総合ソリューションを提案したほか、SiCやGaNなどの新素材に対応した最新装置などを紹介しました。

当社グループは、独創的な製品群の提供を通じ、常にお客様のご要望にお応えしてまいります。



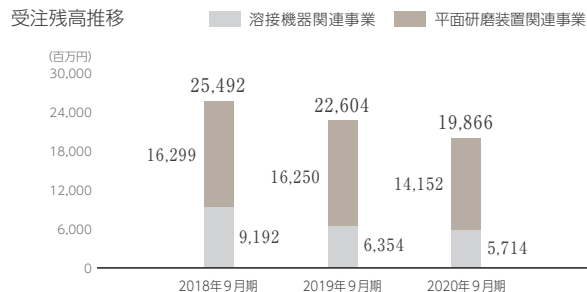
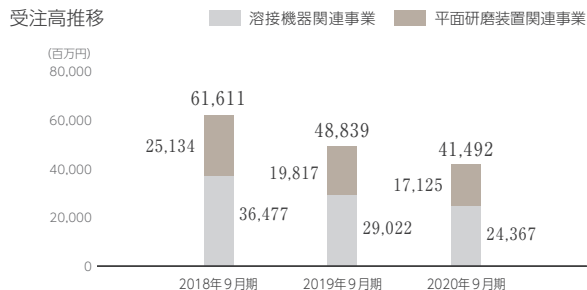
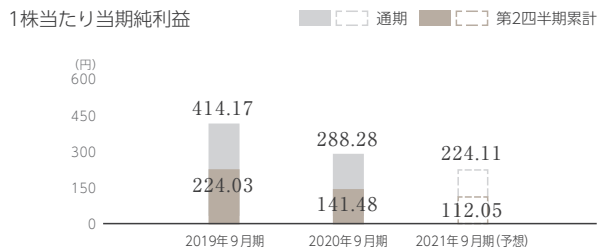
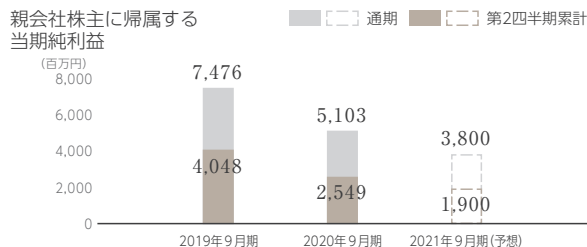
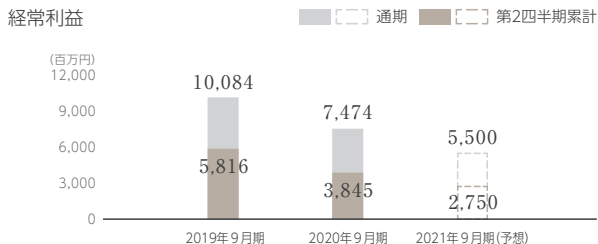
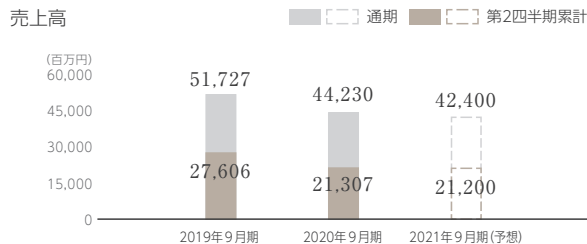
両面研磨装置



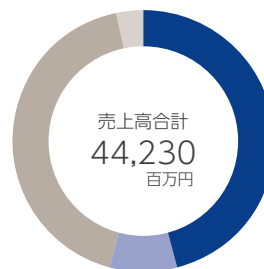
SEMICON Taiwan 2020

主要経営指標の推移

詳細情報は当社IRサイトをご覧ください。 <http://www.obara-g.com/jp/ir/financial/highlight.html>



地域別売上高構成比



- 日本 46.1%
- 米州 8.3%
- アジア・パシフィック 42.5%
- その他 3.1%

(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

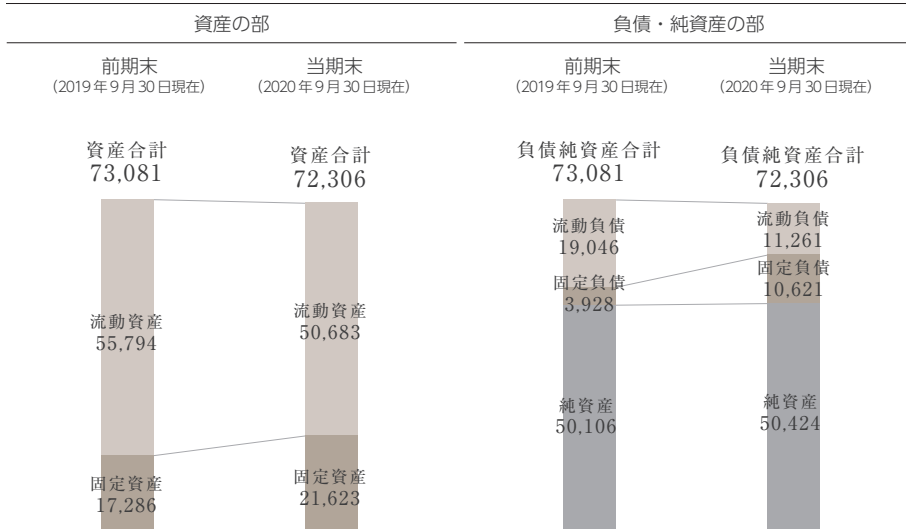
連結財務データ

詳細情報は当社IRサイトをご覧ください。 <http://www.obara-g.com/jp/ir/library/index.html>



資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



point
1

資産負債

総資産は723億6百万円と、前期末に比べて7億74百万円減少しました。

長期預金が46億37百万円増加した一方、現金及び預金が18億80百万円、受取手形及び売掛金が5億14百万円、有価証券が12億56百万円減少したことなどによります。

負債は218億82百万円と、前期末に比べて10億92百万円減少しました。前受金が10億66百万円、転換社債型新株予約権付社債が60億54百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が11億45百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が70億7百万円減少したことなどによります。

point
2

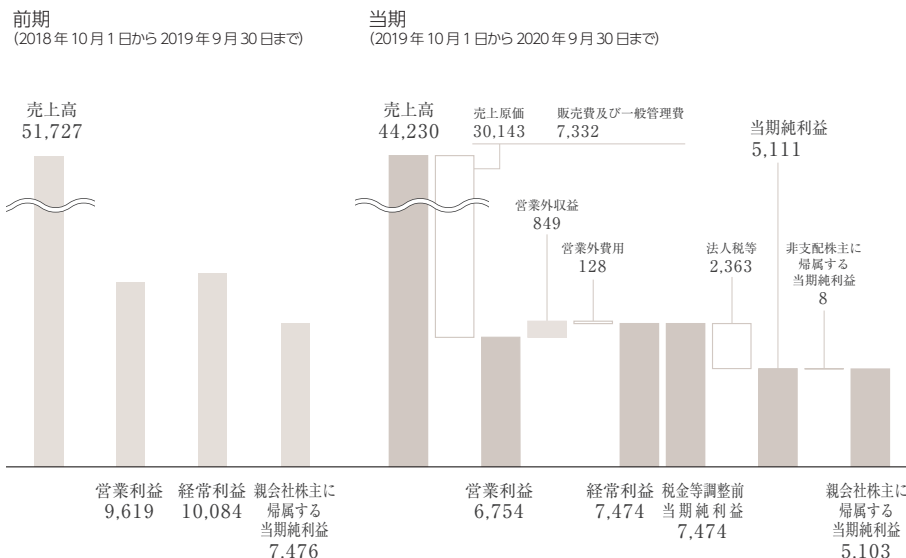
純資産

純資産は504億24百万円と、前期末に比べて3億17百万円増加しました。

自己株式の取得により32億99百万円減少した一方、為替換算調整勘定が5億46百万円、親会社株主に帰属する当期純利益を51億3百万円計上したことなどにより利益剰余金が31億21百万円増加したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



point
3

売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益

連結売上高は、44億30百万円(前期比14.5%減)、営業利益67億54百万円(前期比29.8%減)、経常利益74億74百万円(前期比25.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は、51億3百万円(前期比31.7%減)となりました。

point
4

営業外収支

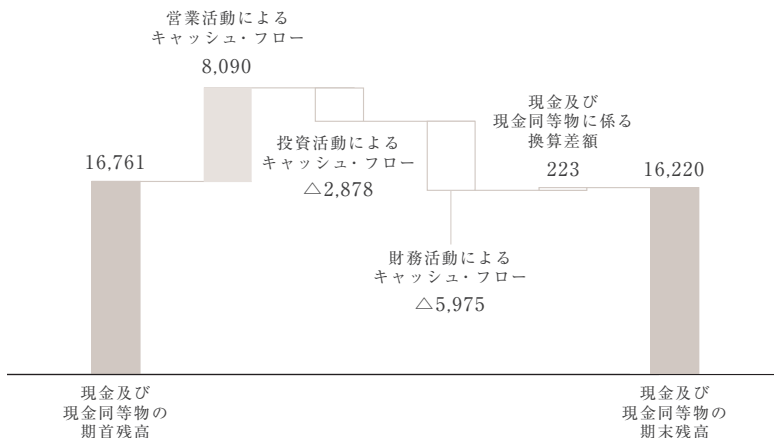
受取利息4億84百万円など、営業外収益が8億49百万円となった一方、社債発行費45百万円など、営業外費用が1億28百万円となりました。

連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当期
(2019年10月1日から2020年9月30日まで)

(単位：百万円)



point
5

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、80億90百万円の資金増加となりました。

仕入債務の減少額が11億19百万円、法人税等の支払額が23億89百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が74億74百万円、減価償却費及びその他の償却費が11億34百万円、売上債権の減少額が9億35百万円、たな卸資産の減少額が9億1百万円発生したことなどによります。

point
6

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は28億78百万円の資金減少となりました。

定期預金の純減少額が27億50百万円となった一方、長期預金の預入による支出が46億20百万円、有形固定資産の取得による支出が13億34百万円発生したことなどによります。

point
7

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は59億75百万円の資金減少となりました。

社債の発行による収入が60億14百万円となった一方、社債の償還による支出が70億円、自己株式の取得による支出が32億99百万円、配当金の支払額が19億83百万円発生したことなどによります。

15

会社情報

会社概要

(2020年9月30日現在)

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	単体：22名(連結 1,761名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-2111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・ 推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康嗣
取締役	小林 憲史
取締役	山下 光久
社外取締役	大西 倫雄*
社外取締役	牧野 宏司*
常勤監査役	高井 清
社外監査役	須山 正志*
社外監査役	高橋 昌子*

* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

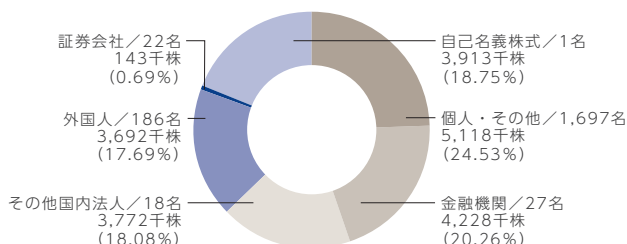
16

株式情報 (2020年9月30日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	1,951名

株主分布状況



株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各本支店

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	21.84
小原康嗣	2,571	15.16
株式会社日本カストディ銀行 (信託口9)	1,098	6.47
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	903	5.32
JP MORGAN CHASE BANK 385635	885	5.22
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	620	3.65
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	461	2.72
株式会社三菱UFJ銀行	369	2.18
小原範子	304	1.79
株式会社日本カストディ銀行 (信託口5)	243	1.43

- (注) 1. 上記のほか、自己株式 3,913千株を保有しております。
2. 持株比率は、自己株式 3,913千株を控除して計算しております。
3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

公告方法

当社公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

年間IRスケジュール

